

RK3326 EVB

用户指南

发布版本:V1.0
日期:2018.07.09

免责声明

您购买的产品、服务或特性等应受瑞芯微电子股份有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，瑞芯微电子股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标声明

Rockchip、Rockchip™图标、瑞芯微和其他瑞芯微商标均为福州瑞芯微电子股份有限公司的商标，并归瑞芯微电子股份有限公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

版权所有 © 福州市瑞芯微电子股份有限公司 2018

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

前言

概述

本文档主要介绍RK3326 EVB单板基本功能特点和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法，旨在帮助开发人员更快、更准确地使用RK3326 EVB，熟悉RK3326芯片方案。

产品版本

本文档对应的产品版本如下：

产品名称	产品版本
RK3326 EVB	RK_EVB_RK3326_LP3S178P132SD4_V11_20180301LX_Final

适用对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 单板硬件开发工程师
- 嵌入式软件开发工程师
- 测试工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本号	作者	修订说明
2018-07-09	V1.0	WHB/LX	Initial Release

缩略语

缩略语包括文档中常用词组的简称。

DDR	Double Data Rate	双倍速率同步动态随机存储器
eMMC	Embedded Multi Media Card	内嵌式多媒体存储卡
I ² C	Inter-Integrated Circuit	内部整合电路(两线式串行通讯总线)
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试行为组织定义的一种国际标准测试协议 (IEEE 1149.1 兼容)
LDO	Low Drop Out Linear Regulator	低压差线性稳压器
LVDS	Low-Voltage Differential Signaling	低电压差分信号
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	移动产业处理器接口
PMIC	Power Management IC	电源管理芯片
PMU	Power Management Unit	电源管理单元
RK	Rockchip Electronics Co., Ltd.	瑞芯微电子股份有限公司
SD Card	Secure Digital Memory Card	安全数码卡
SDIO	Secure Digital Input and Output	安全数字输入输出接口
SDMMC	Secure Digital Multi Media Card	安全数字多媒体存储卡
TF Card	Micro SD Card (Trans-flash Card)	外置记忆卡
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线

目录

前言	3
概述	3
产品版本	3
适用对象	3
修订记录	4
缩略语	5
目录	6
插图目录	8
表格目录	9
1. 概述	10
1.1 EVB开发平台简介	10
1.2 EVB系统框图	11
1.3 功能概述	12
1.4 EVB默认烧录功能	13
1.5 EVB组件	14
2. EVB硬件介绍	15
2.1 整体效果图	15
2.2 结构与接口示意图	16
2.3 电源框图	18
2.4 I ² C地址	18
2.5 开发板参考图	19
3. EVB Main Board模块简述	20
3.1 电源输入	20
3.2 存储器	20
3.2.1 EMMC	20
3.2.2 DDR	21
3.3 按键输入	21
3.4 G-Sensor输出	22
3.5 Compass输出	23
3.6 音频输入输出	24
3.7 USB OTG插座	24
3.8 TF Card插座	25
3.9 Camera插座	25
3.10 WIFI+BT模组	27
3.11 LCM MIPI接口	30
3.12 RGB扩展座	31
3.13 Raspberry Pi 接口	33
3.14 UART Debug调试座	35
3.15 JTAG Debug调试座	36
4. 开发板使用	37
4.1 EVB开关机和待机	37
4.2 USB驱动安装	37
4.3 EVB固件烧写	38

4.3.1 Maskrom烧写模式	38
4.3.2 Loader烧写模式	38
4.4串口调试	39
4.4.1 连接串口	39
4.4.2 ADB调试	41
5. 注意事项	42
5.1 注意事项	42

Rockchip Confidential

插图目录

图 1-1 RK3326芯片架构	11
图 1-2 EVB系统框图	12
图 1-3 RK3326 EVB 1.1 PCB上TOP Layer模块布局位置图	13
图 1-4 RK3326 EVB 1.1 PCB上bottom Layer模块布局位置图	13
图 2-1 EVB整体实物图正面	15
图 2-2 EVB整体实物图背面	16
图 2-3 EVB实物图正面	17
图 2-4 EVB实物图背面	17
图 2-5 EVB电源框图	18
图 3-1 EVB电源输入	20
图 3-2 EVB Memory eMMC.....	21
图 3-3 LPDDR3位置和实物图.....	21
图 3-4 EVB按键.....	22
图 3-5 EVB按键组合原理图.....	22
图 3-6 EVB重力加速度传感器	23
图 3-7 EVB指南针	23
图 3-8 EVB音频输入输出.....	24
图 3-9 EVB喇叭输出	24
图 3-10 EVB USB OTG插座	25
图 3-11 EVB TF插座	25
图 3-12 EVB Camera座	26
图 3-13 CIF Camera电源选择	26
图 3-14 EVB WIFI+BT模组	28
图 3-15 EVB WIFI+BT扩展座.....	28
图 3-16 EVB WIFI+BT扩展座所对应的网络名称.....	29
图 3-17 EVB LCM MIPI接口	30
图 3-18 EVB RGB扩展座	32
图 3-19 RGB扩展座信号选择.....	32
图 3-20 J9301所对应的网络名称	33
图 3-21 EVB Raspberry Pi接口	34
图 3-22 树莓派接口（J9300）引脚网络名称	34
图 3-23 EVB UART Debug调试座（Mini USB）	36
图 3-24 EVB JTAG Debug调试座	36
图 4-1 驱动安装成功示意图.....	37
图 4-2 进入Maskrom烧写模式工具上示意图	38
图 4-3 进入Loader烧写模式工具上示意图	39
图 4-4 获取当前端口COM号	39
图 4-5 串口工具SecureCRT界面	40
图 4-6 配置串口信息.....	40
图 4-7 配置串口工具选项	41
图 4-8 ADB连接正常	41

表格目录

表 1-1 RK3326 EVB功能表	13
表 2-1 EVB器件I2C地址表	18
表 3-1 MIPI Camera 网络名称及主控引脚名称.....	26
表 3-2 CIF Camera网络名称及主控引脚名称	27
表 3-3 WIFI扩展座网络接口及对应主控引脚名称	29
表 3-4 LCM MIPI接口引脚网络名称及对应主控引脚名称.....	30
表 3-5 J9301接口所对应的网络名称及主控引脚名称	33
表 3-6 树莓派接口（J9300）引脚网络名称及对应主控引脚名称	34

1. 概述

1.1 EVB开发平台简介

RK3326 EVB是针对瑞芯微电子RK3326多媒体处理芯片（以下简称RK3326芯片）开发的集参考设计、芯片调试和测试、芯片验证一体的硬件开发板，用于给客户展示RK3326芯片强大的多媒体接口和丰富的外围接口，同时为客户提供基于RK3326芯片的硬件参考设计，使客户不需修改或者只需要简单修改参考设计的模块电路，就可以完成产品的硬件开发。RK3326 EVB支持RK3326芯片的EVB开发、应用软件的开发和运行等，因为考虑到不同的使用环境，对芯片进行全功能验证，所以各种接口齐全，设计相对比较复杂。

RK3326 EVB可通过USB线与电脑连接，做为一个基本开发系统使用，或实现更完全的开发系统或演示环境，此时连接如下设备或部件：

- 电源
- LCM MIPI屏
- TF Card存储设备
- 耳机或音箱
- 摄像头模组

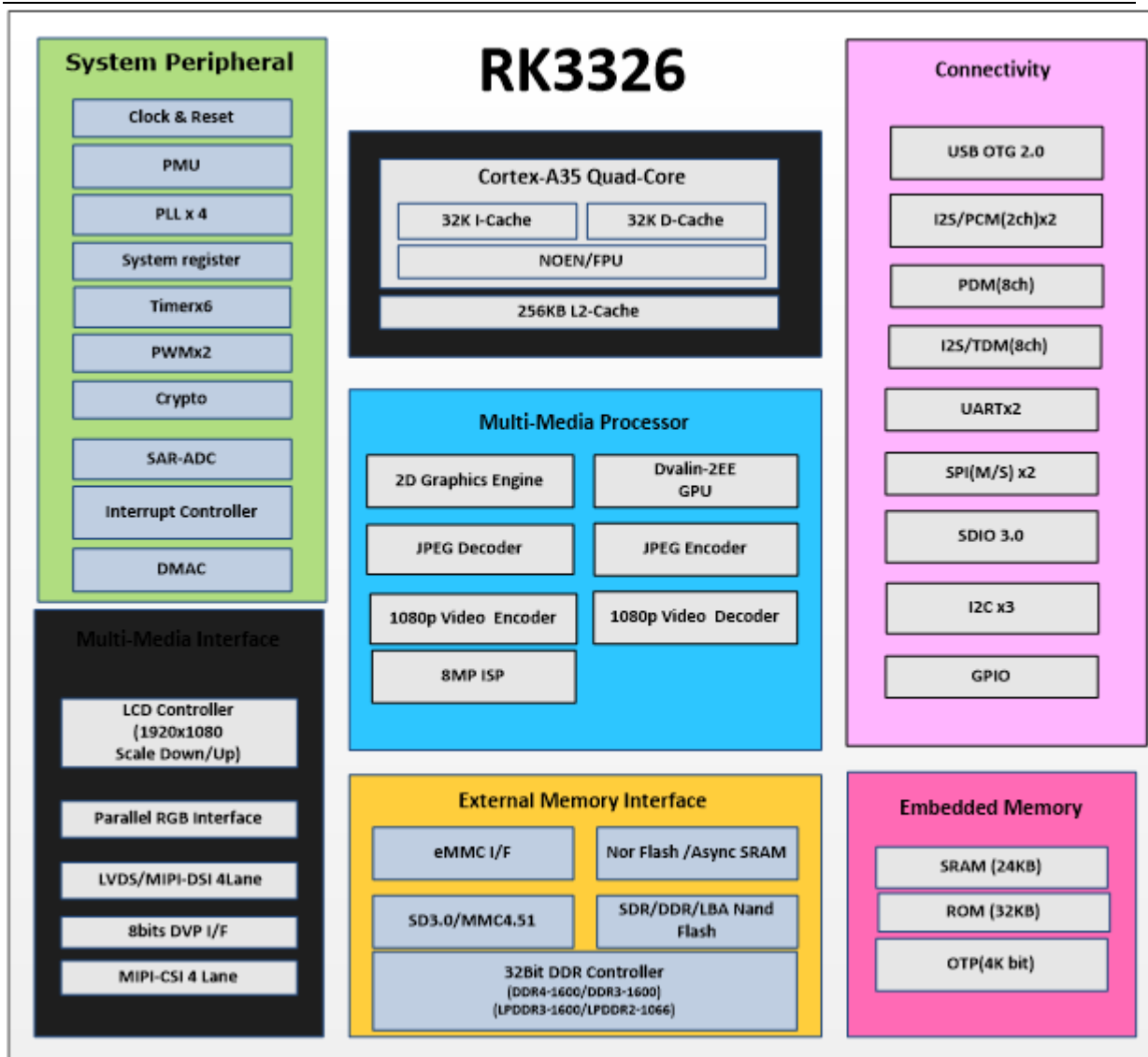


图 1-1 RK3326芯片架构

1.2 EVB系统框图

系统框图可以让开发人员对整个系统的架构和原理有一个直观的认识，整个系统由电源适配器或者电池供电，通过UART串口、JTAG接口进行调试，验证各功能模块。开发板带有大部分接口，配有Camera输入，WIFI+BT模组，USB OTG，TF卡，音频接口，视频接口，满足大多数情况下不同应用需求，有利于芯片方案的深入研发与快速产品化。

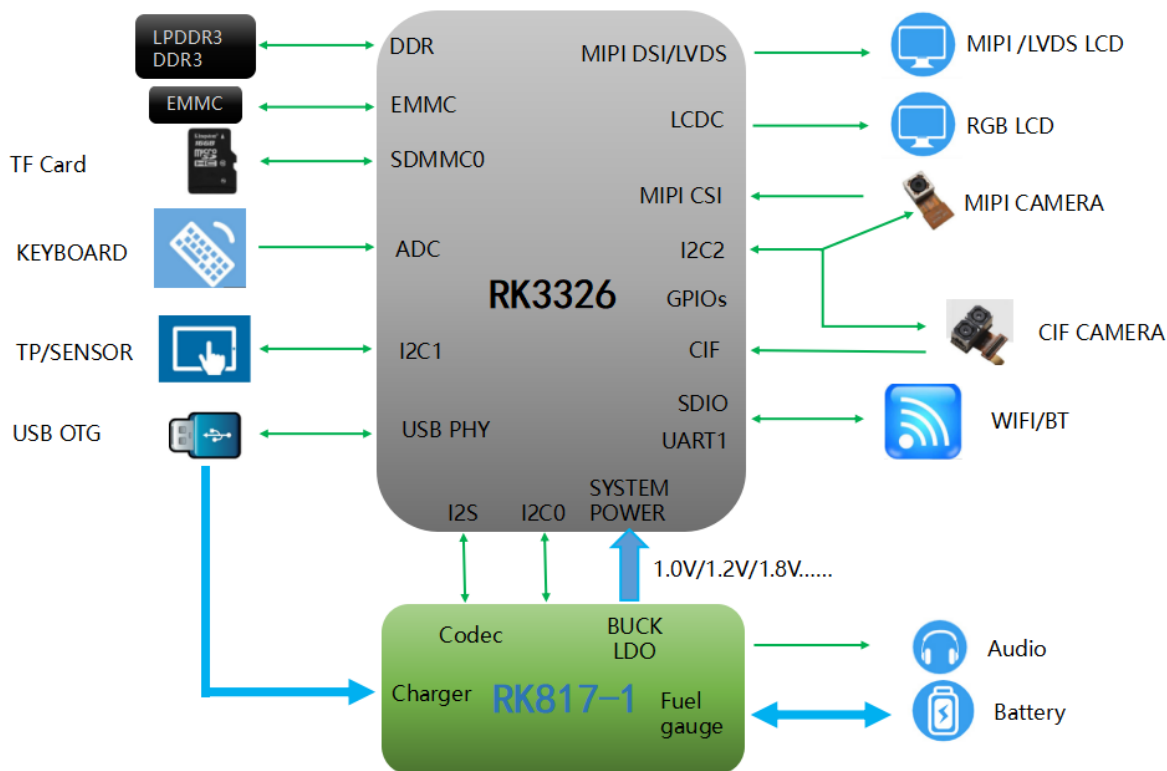


图 1-2 EVB系统框图

1.3 功能概述

RK3326 EVB包含的功能如下：

- RK817-1充电及电源路径管理系统
- 32bit LPDDR3，总容量2GByte
- 8bit eMMC，总容量16GByte
- TF Card：支持外部扩展存储容量
- USB OTG：系统升级使用，可以支持Host/Device切换
- 系统按键：Power、Menu、Esc、VOL+、VOL-、Home、Reset、Maskrom
- SDIO Wifi（AP6212）：支持无线上网功能
- Audio out：支持耳机、扬声器
- Audio in：支持录音
- Uart Debug：开发板Debug使用
- Sensor：G-sensor MMA7660FC、Compass AK8963C
- CIF Camera：IMX323，200W像素
- MIPI Camera：OV5695，500W像素
- 扩展接口包含：JTAG、WIFI、RGB、Raspberry Pi

功能模块布局如下：

TOP Layer:

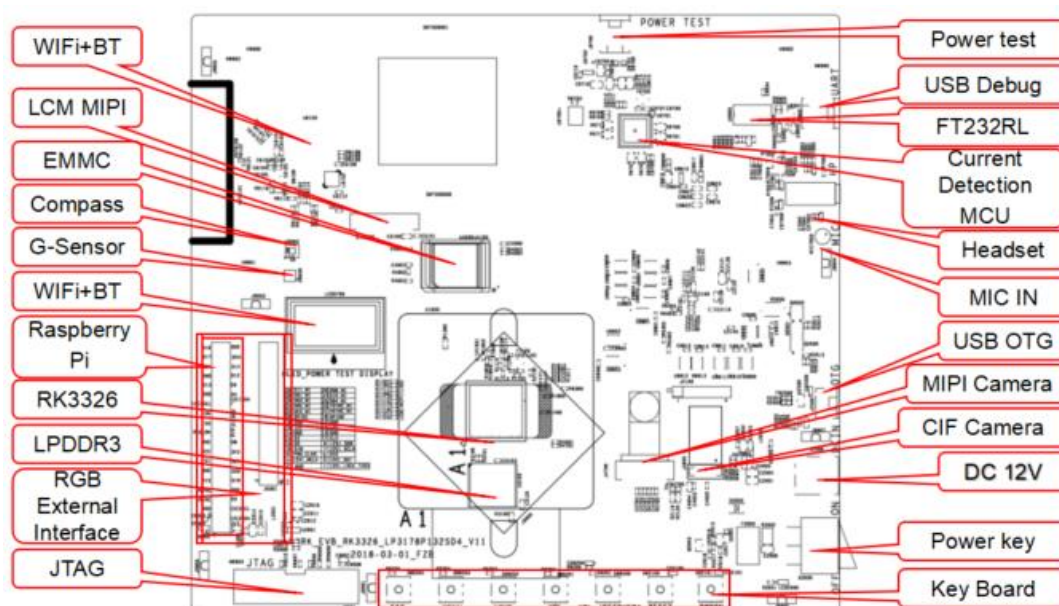


图 1-3 RK3326 EVB 1.1 PCB上TOP Layer模块布局位置图

Bottom Layer:

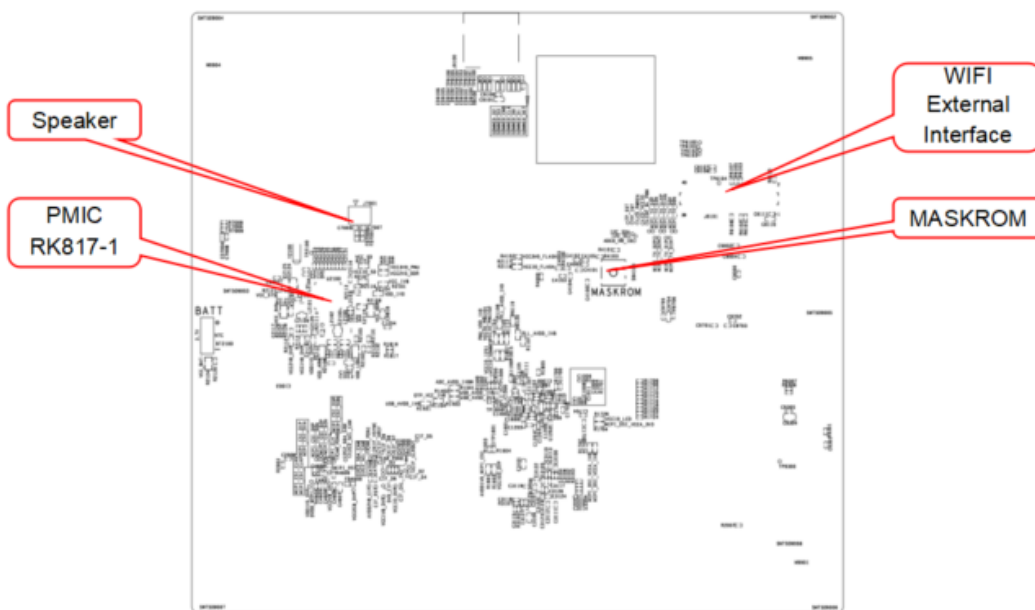


图 1-4 RK3326 EVB 1.1 PCB上bottom Layer模块布局位置图

1.4 EVB默认烧录功能

开发板默认已经有烧录固件的，涵盖所有的功能如下表：

表 1-1 RK3326 EVB功能表

序号	EVB功能	满足要求
1	PMIC RK817-1	单节电池可以充放电、电量检测正常
2	DDR LPDDR3	可识别到总容量2GByte
3	eMMC	可以正常识别容量16GByte

4	串口FT232RL	可以正常输入和输出
5	USB OTG	可以认到ADB设备，可以下载固件
6	TF Card	正常识别TF Card
7	Audio codec	耳机播放正常，喇叭正常，两者切换正常
8	G-Sensor	MMA7660FC功能正常
9	KEY BAORD	所有按键功能正常
10	WIFI/BT	AP6212模组，WIFI/BT功能正常
11	MIPI/CIF Camera	摄像头功能正常，默认MIPI摄像头输入
12	二级待机唤醒	可以正常待机和唤醒系统

1.5 EVB组件

RK3326 EVB主要包括以下物品：

- RK3326 EVB
- 电源适配器，规格：输入 100V AC~240V AC，50Hz；输出 12V DC，2A
- 显示屏，规格：MIPI；尺寸：5.5寸；分辨率：1280x720

开发板有如下扩展组件，可选配：

- 扩展RGB：规格：RGB 24bit，分辨率：1920x1080

2.EVB硬件介绍

2.1 整体效果图

EVB整体实物图

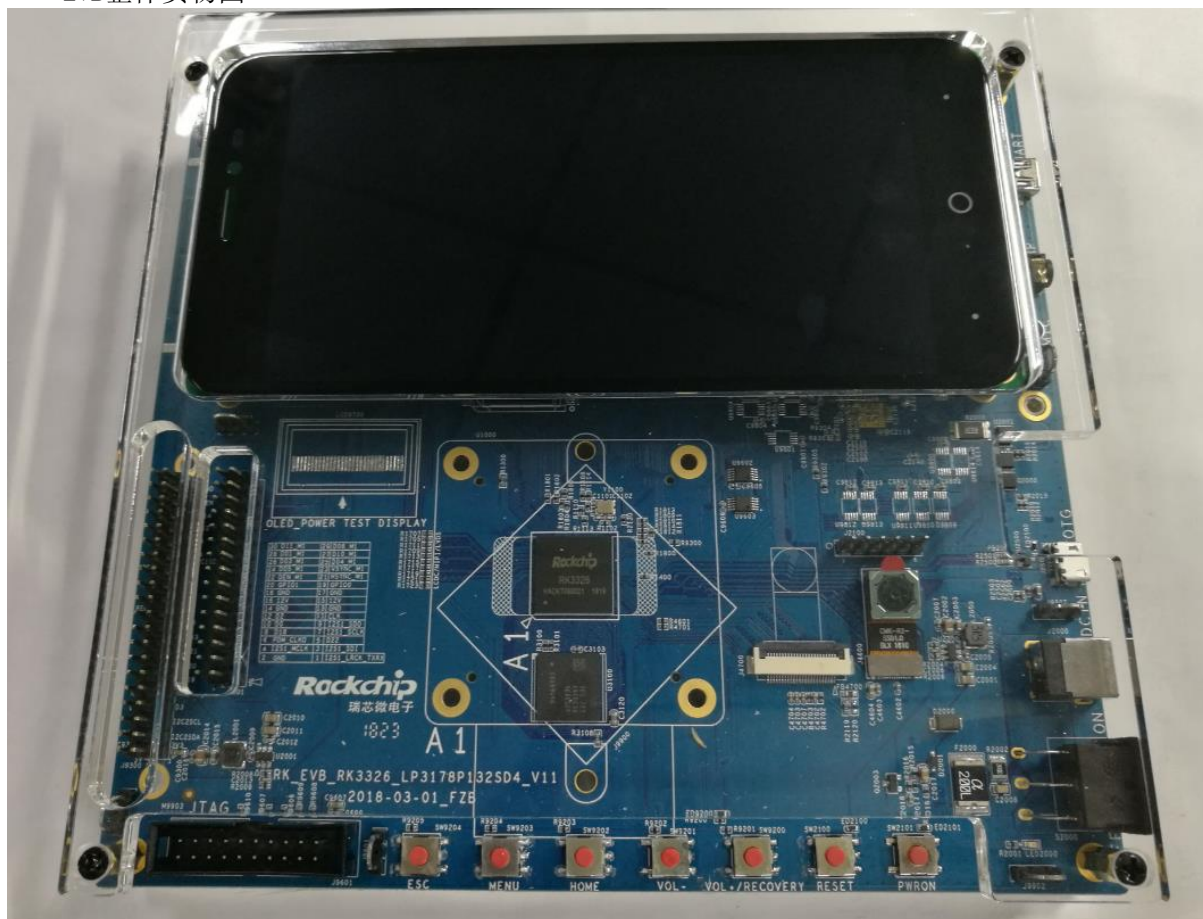


图 2-1 EVB整体实物图正面

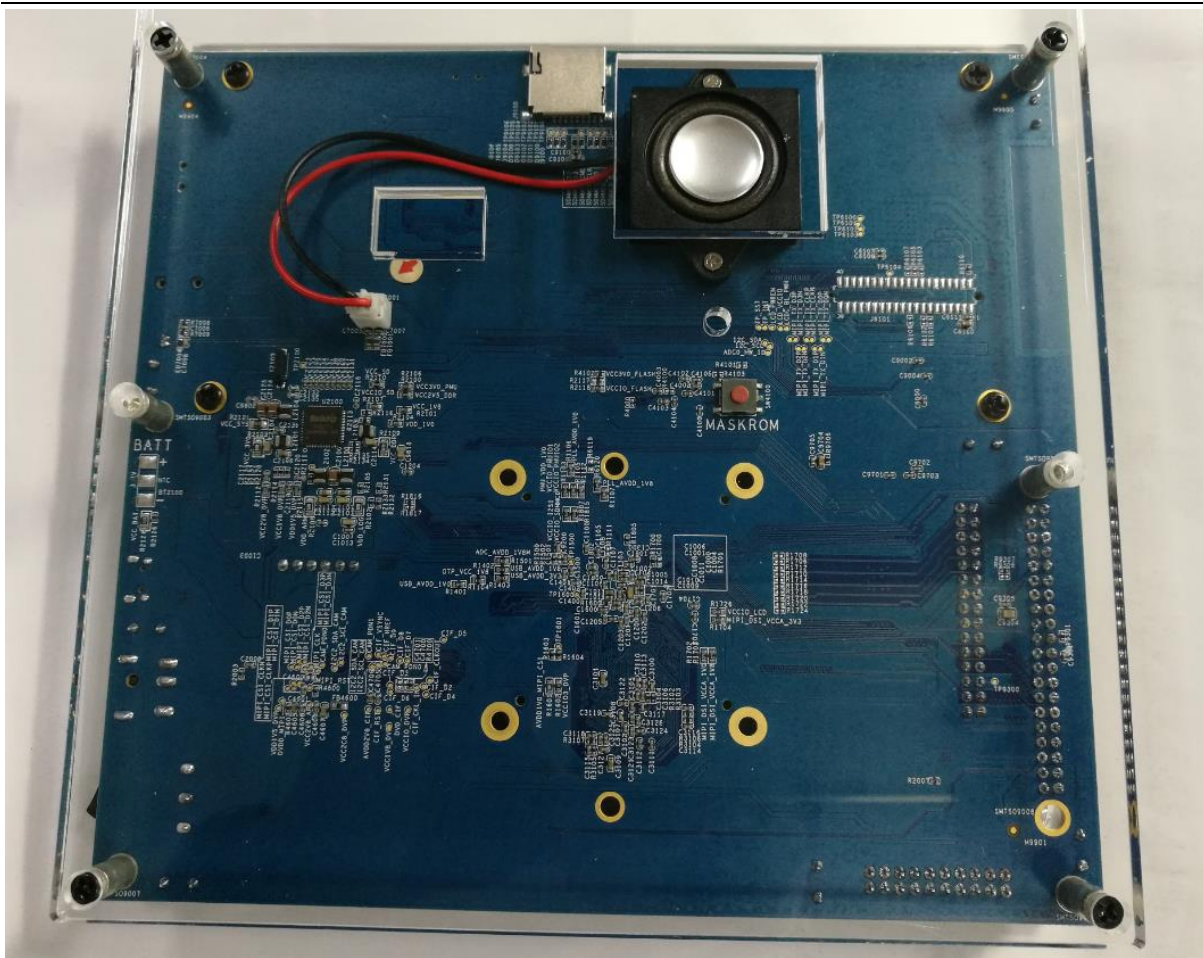


图 2-2 EVB整体实物图背面

2.2 结构与接口示意图

RK3326 EVB的实物照片如下：

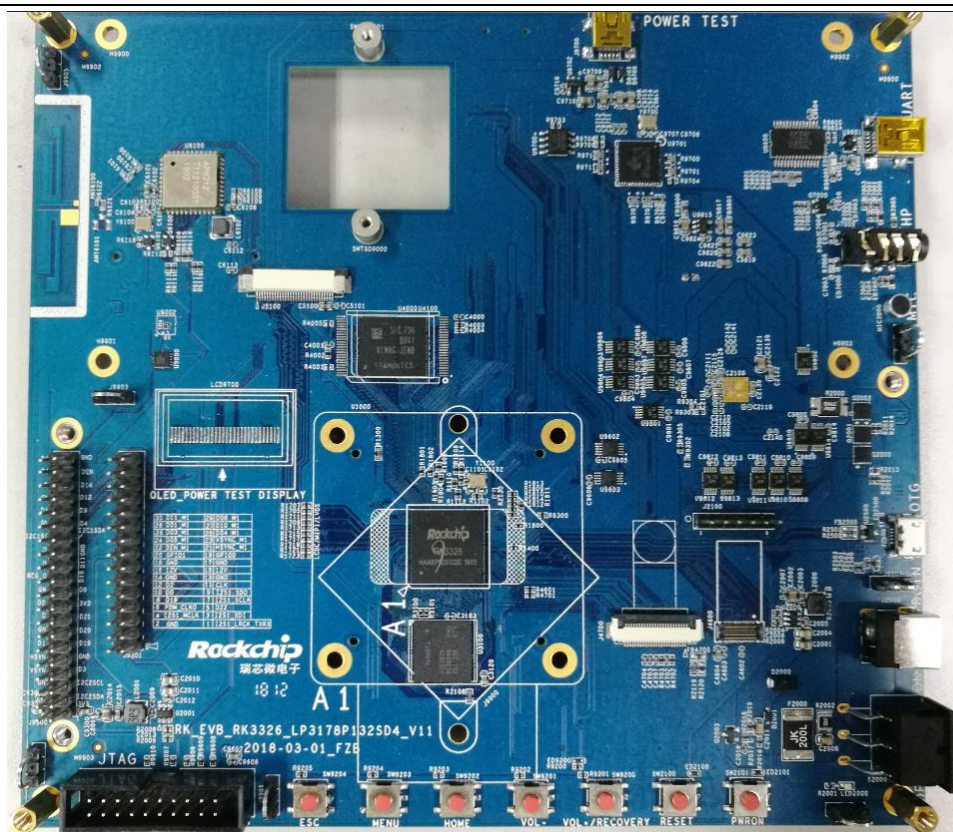


图 2-3 EVB实物图正面

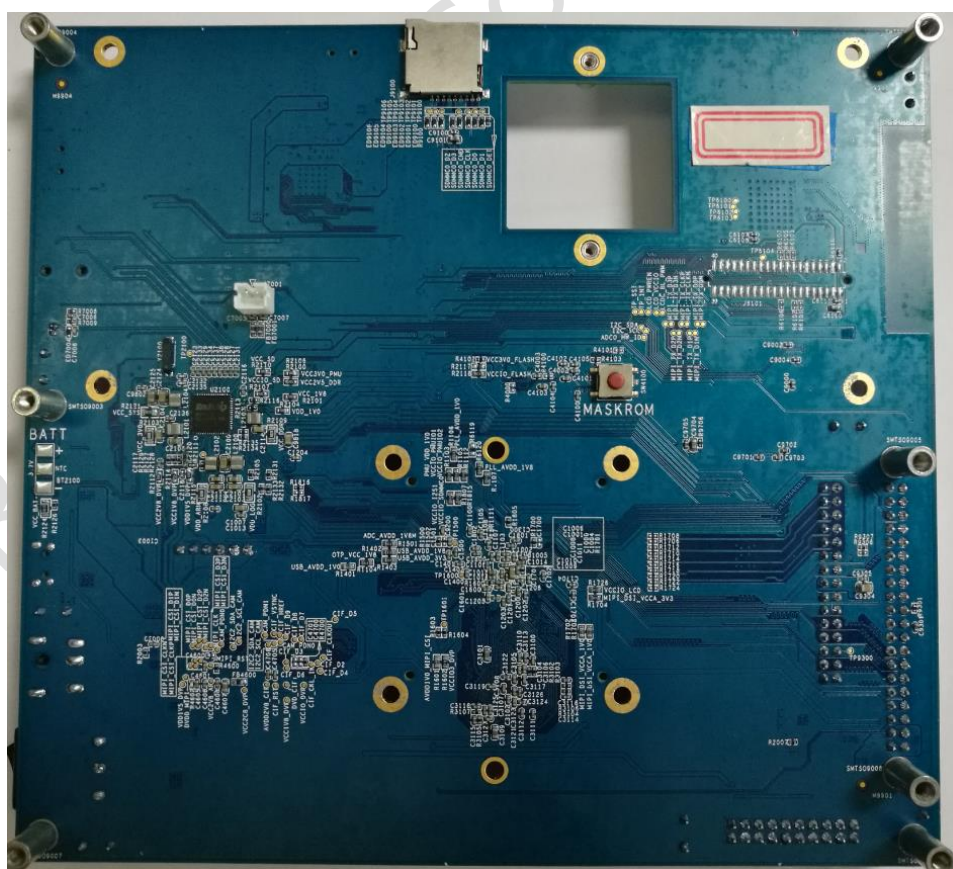


图 2-4 EVB实物图背面

2.3 电源框图

RK3326 EVb电源使用的PMIC是RK817-1，电源框图如下图。

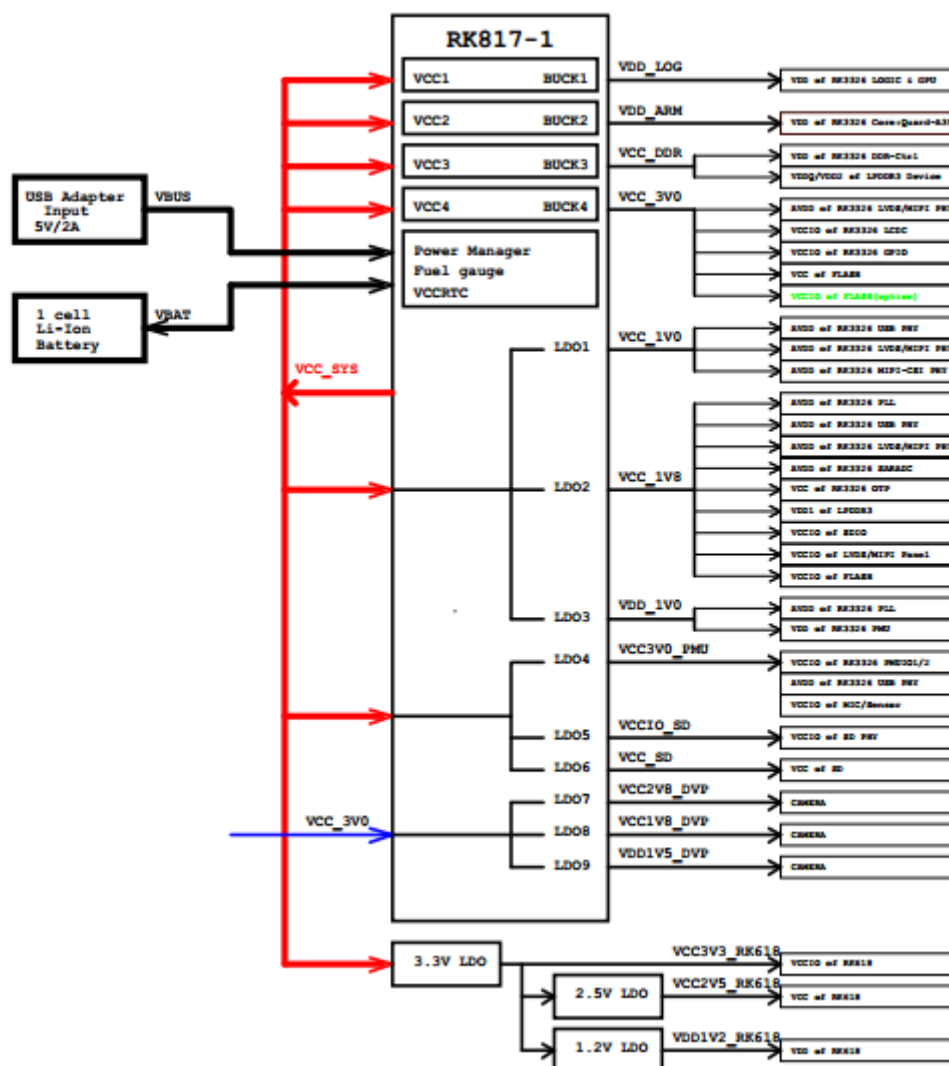


图 2-5 EVb电源框图

2.4 I²C地址

RK3326 EVb的外围器件I²C (7bit) 地址配置如下表：

表 2-1 EVb器件I2C地址表

	设备	地址
I ² C0	RK817	0x20
	RK618	0x50
I ² C1	MMA8452Q	0x1d
	LIS3DH	0x19
	LSM303D	0x1d

	GSL1680	0x40
	GSL3676	0x40
I ² C2	OV5695	0x36
	IMX323	0x1a

注意 :使用扩展板时, 要保证板上I²C地址与开发板上I²C地址不冲突。

2.5 开发板参考图

RK3326 EVB对应的参考图对应如下, 如有需要, 请向我司FAE索取。

《RK_EVB_RK3326_LP3S178P132SD4_V11_20180301LX_Final.dsn》

《RK_EVB_RK3326_LP3S178P132SD4_11_20180301FZB_final.brd》

3.EVB Main Board模块简述

3.1 电源输入

电源适配器输入的12V/2A电源，可以通过船型开关来控制电源ON/OFF，板上的SY8113B BUCK芯片对12V降压为3.8V后为PMIC提供输入，由PMIC输出其余各组电压供开发板使用。

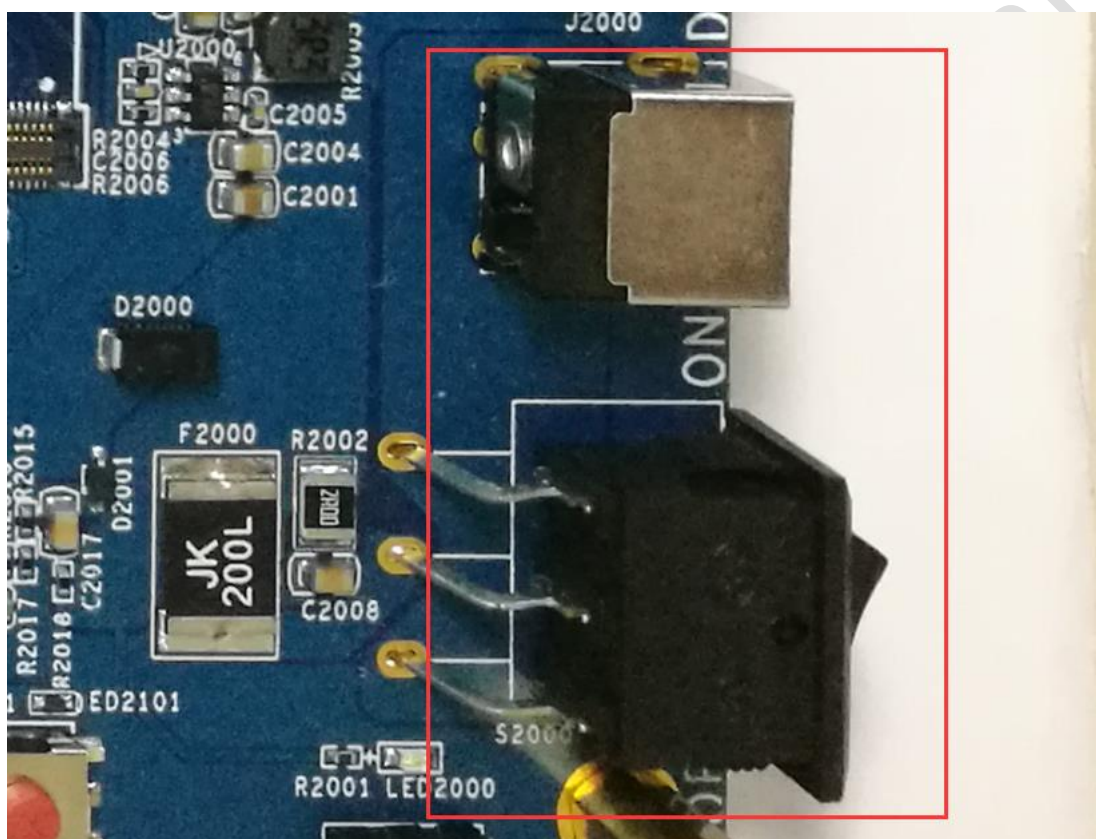


图 3-1 EVB电源输入

3.2 存储器

3.2.1 EMMC

1. 开发板上的默认存储为16GByte eMMC FLASH，同时预留了Nand Flash位置，可以支持8bit Nand Flash。
2. Flash背面配有Update升级按键，方便开发板固件升级。连接USB，按住SW4100上电或复位，系统将进入MaskRom固件烧写模式。

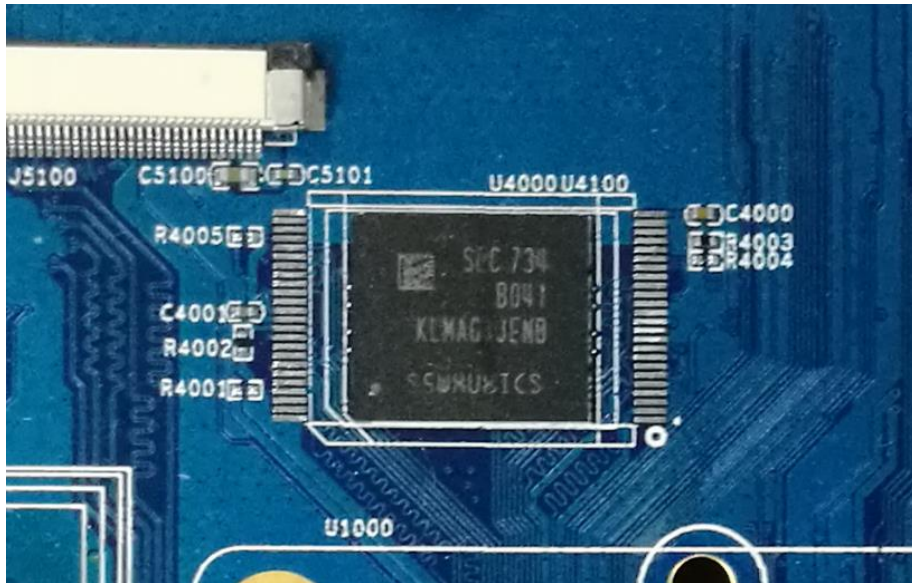


图 3-2 EVB Memory eMMC

3.2.2 DDR

RK3326支持单通道32bit DDR，EVB采用单颗32bit LPDDR3，默认总容量为2GByte。

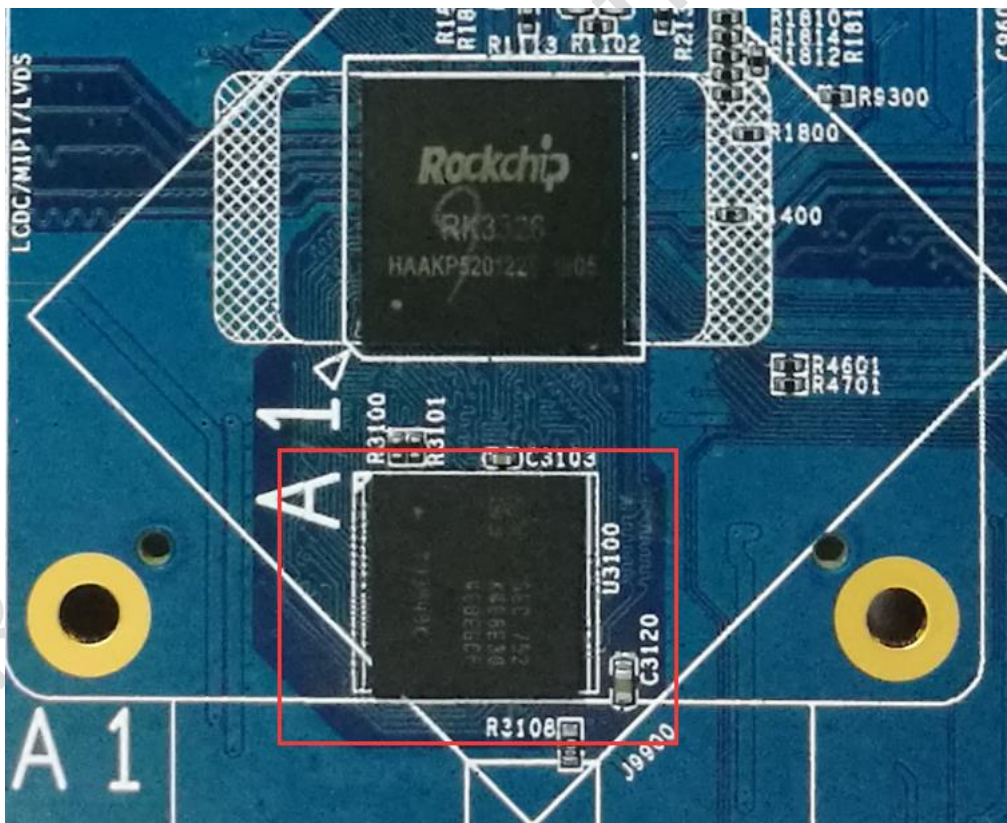


图 3-3 LPDDR3位置和实物图

3.3 按键输入

1. 开发板提供按键组合应用，使用RK3326 ADC_IN2作为检测口，支持10位分辨率。
2. ADC供电电压由VCC_1V8提供，可根据图3-5的电阻参数，计算对应的按键键值。

3. 开发板上定义了常用的几个按键：VOL+/VOL-/MENU/ESC/HOME。
4. 连接USB，按住VOL+/Recovery按键上电（或复位），可以进入Rockusb烧写模式。

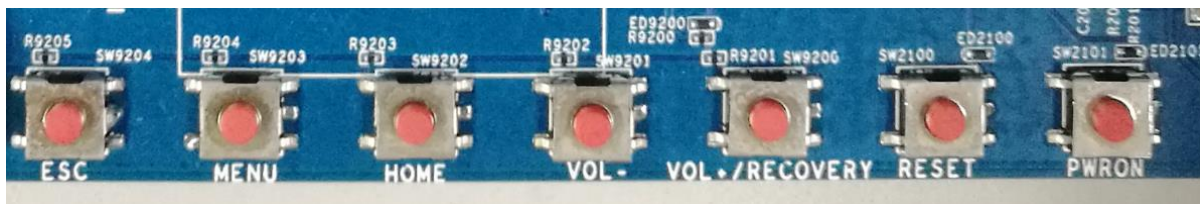


图 3-4 EVB按键

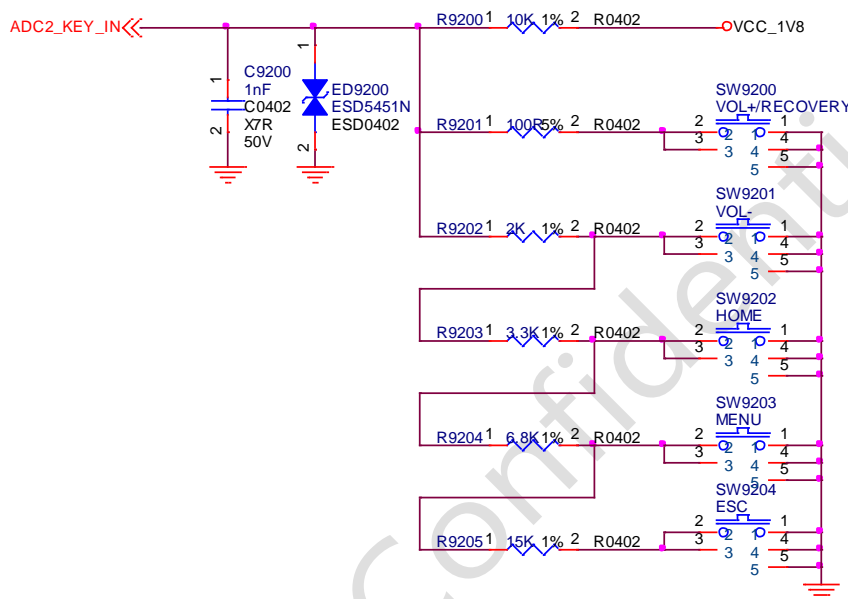


图 3-5 EVB按键组合原理图

3.4 G-Sensor输出

开发板所用的重力加速度传感器MMA7660FC为±1.5g三轴数字输出的I2C，超低功率，紧凑型电容式微电机的加速度计，如下图所示。

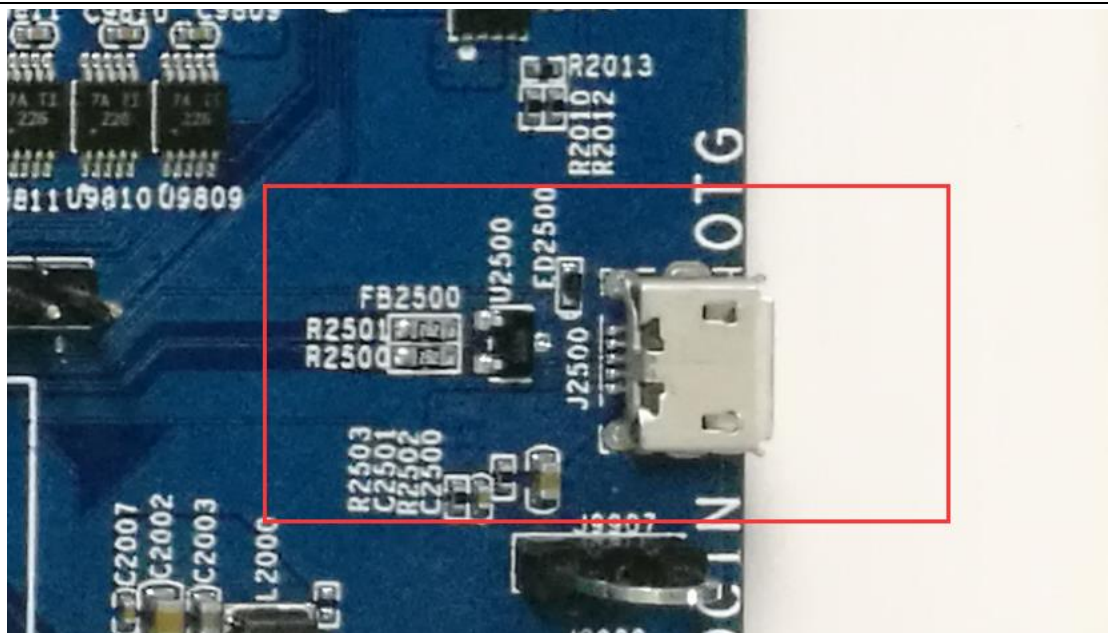


图 3-10 EVB USB OTG插座

3.8 TFCard插座

开发板带TF卡接口，如下图所示，支持SDMMC 2.0/3.0，数据总线宽度是4bits。

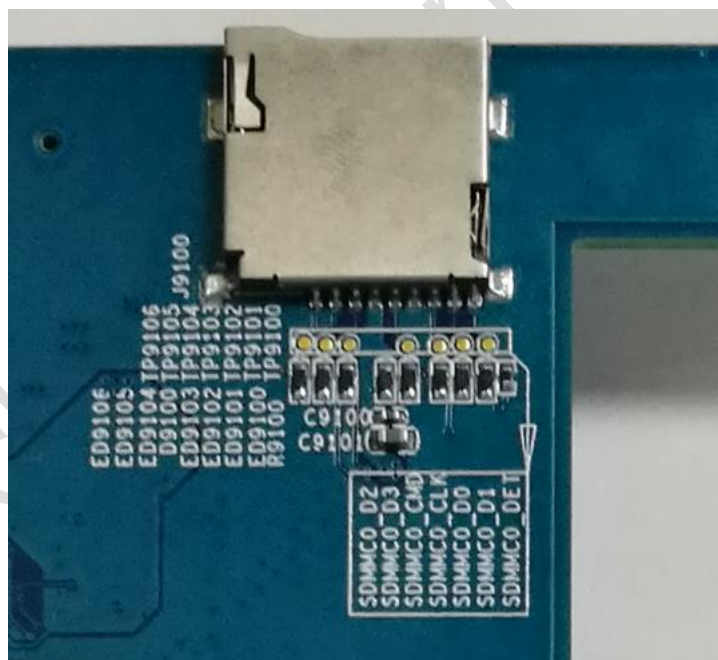


图 3-11 EVB TF插座

3.9 Camera插座

开发板摄像头插座支持MIPI CSI和CIF两种摄像头模组，插座如图3-12。使用CIF Camera时请注意电平匹配，否则会造成Camera工作异常或无法工作。CIF Camera IO电源默认1.8V，如图3-13所示，若要使用2.8V，则需要将R2120焊接到R2119。

20	I2C2_SCL_CAM	I2C2_SCL/GPI02_B7_u
21	I2C2_SDA_CAM	I2C2_SDA/GPI02_C0_u
22	DVDD_MIPI	N/A
23	GND	GND
24	VCC1V8_DVP	N/A
25	GND	GND
26	MIPI_CSI_D1N	MIPI_CSI_D1N
27	MIPI_CSI_D1P	MIPI_CSI_D1P
28	GND	GND
29	MIPI_CSI_CLKP	MIPI_CSI_CLKP
30	MIPI_CSI_CLKN	MIPI_CSI_CLKN
31	GND	GND
32	GND	GND
33	GND	GND
34	GND	GND

表 3-2 CIF Camera网络名称及主控引脚名称

CIF Camera插座引脚号	CIF Camera插座引脚网络名称	CIF Camera对应主控引脚名称
1	CAM_PDN1	GPI02_B5_d
2	GND	GND
3	I2C2_SDA_CAM	I2C2_SDA/GPI02_C0_u
4	AVDD2V8_CIF	N/A
5	I2C2_SCL_CAM	I2C2_SCL/GPI02_B7_u
6	CIF_RST	N/A
7	CIF_VSYNC	CIF_VSYNC_M0/GPI02_B0_d
8	CAM_PDNO	UART2_RX_M1/GPI02_B6_d
9	CIF_HREF	CIF_HREF_M0/GPI02_B1_d
10	DVDD_CIF	N/A
11	VCCIO_DVP	VCCIO3
12	CIF_D9	CIF_D9_M0/GPI02_A7_d
13	CIF_CLKOUT	CIF_CLK0_M0/GPI02_B3_d
14	CIF_D8	CIF_D8_M0/GPI02_A6_d
15	GND	GND
16	CIF_D7	CIF_D7_M0/GPI02_A5_d
17	CIF_CLK_IN	CIF_CLK1_M0/GPI02_B2_d
18	CIF_D6	CIF_D6_M0/GPI02_A4_d
19	CIF_D2	CIF_D2_M0/GPI02_A0_d
20	CIF_D5	CIF_D5_M0/GPI02_A3_d
21	CIF_D3	CIF_D3_M0/GPI02_A1_d
22	CIF_D4	CIF_D4_M0/GPI02_A2_d
23	NC	N/A
24	NC	N/A
25	GND	GND
26	GND	GND

3.10 WIFI+BT模组

开发板上WIFI+BT模组采用台湾正基的AP6212模组，如图3-14，其特性如下：

- 支持WIFI (802.11 b/g/n)、BT4.1、FM功能。

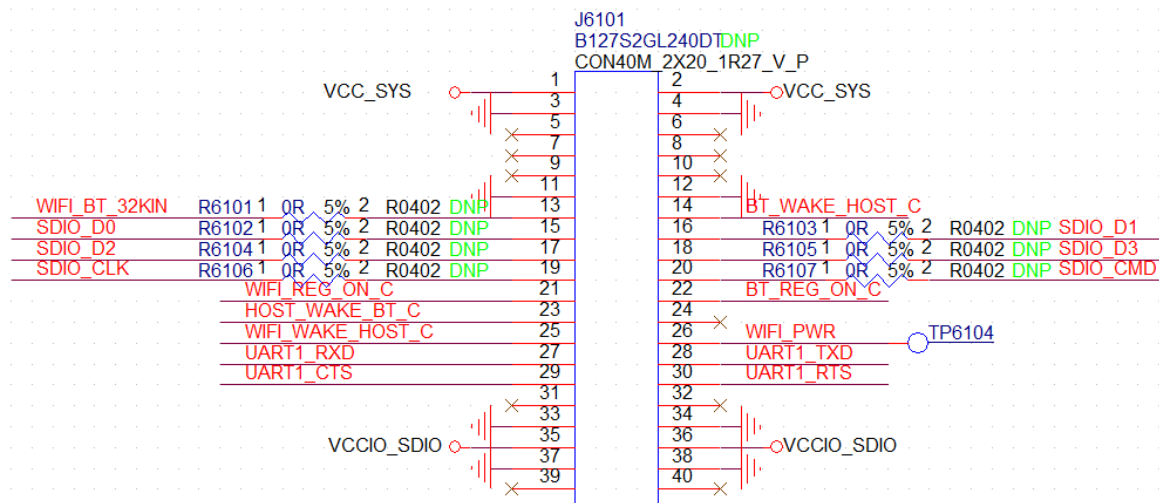


图 3-16 EVB WIFI+BT扩展座所对应的网络名称

表 3-3 WIFI扩展座网络接口及对应主控引脚名称

WiFi扩展座引脚号	WiFi扩展座引脚网络名称	WiFi扩展座对应主控引脚名称
1	VCC_SYS	N/A
2	VCC_SYS	N/A
3	GND	GND
4	GND	GND
5	NC	N/A
6	NC	N/A
7	NC	N/A
8	NC	N/A
9	NC	N/A
10	NC	N/A
11	GND	GND
12	GND	GND
13	WIFI_BT_32KIN	CLKIO_32K/GPI00_C4_z
14	BT_WAKE_HOST_C	GPI00_B3_d
15	SDIO_D0	SDIO_D0/GPI01_C6_u
16	SDIO_D1	SDIO_D1/GPI01_C7_u
17	SDIO_D2	SDIO_D2/GPI01_D0_u
18	SDIO_D3	SDIO_D3/GPI01_D1_u
19	SDIO_CLK	SDIO_CLK/GPI01_C5_u
20	SDIO_CMD	SDIO_CMD/GPI01_C4_u
21	WIFI_REG_ON_C	GPI00_A2_d
22	BT_REG_ON_C	GPI00_C1_d
23	HOST_WAKE_BT_C	GPI00_A1_d
24	NC	N/A
25	WIFI_WAKE_HOST_C	GPI00_B2_d
26	WIFI_PWR	N/A
27	UART1_RXD	UART1_RXD/GPI01_C0_u
28	UART1_TXD	UART1_TXD/GPI01_C1_u
29	UART1_CTS	UART1_CTS/GPI01_C2_u
30	UART1_RTS	UART1_RTS/GPI01_C3_u

6	LCM_LVDS/MIPI_TX_D1P	LVDS/MIPI_TX_D1P/LCDC_D10_M1
7	GND	GND
8	LCM_LVDS/MIPI_TX_CLKN	LVDS/MIPI_TX_CLKN/LCDC_D4_M1
9	LCM_LVDS/MIPI_TX_CLKP	LVDS/MIPI_TX_CLKP/LCDC_D3_M1
10	GND	GND
11	LCM_LVDS/MIPI_TX_D2N	LVDS/MIPI_TX_D2N/LCDC_VSYNC_M1
12	LCM_LVDS/MIPI_TX_D2P	LVDS/MIPI_TX_D2P/LCDC_D5_M1
13	GND	GND
14	LCM_LVDS/MIPI_TX_D3N	LVDS/MIPI_TX_D3N/LCDC_HSYNC_M1
15	LCM_LVDS/MIPI_TX_D3P	LVDS/MIPI_TX_D3P/LCDC_DEN_M1
16	GND	GND
17	LCDC_BL_PWM	PWM1/GPI00_CO_d
18	NC	N/A
19	LCD_VCCIO	N/A
20	NC	N/A
21	ADC0_HW_ID	ADC_IN0
22	LCD_PWREM	TEST_CLK1/GPI00_B5_u
23	I2C1_SCL	I2C1_SCL/GPI00_C2_d
24	I2C1_SDA	I2C1_SDA/GPI00_C3_d
25	TP_INT	GPI00_A5_u
26	TP_RST	GPI00_B4_u
27	GND	GND
28	VCC_SYS	N/A
29	VCC_SYS	N/A
30	VCC_SYS	N/A
31	GND	GND
32	GND	GND

3.12 RGB扩展座

开发板上预留RGB扩展座(J9300、J9301)，如下图，若需要选择使用RGB扩展座，需要将图3-18框选电阻（0R）替换到图3-19框选位置。

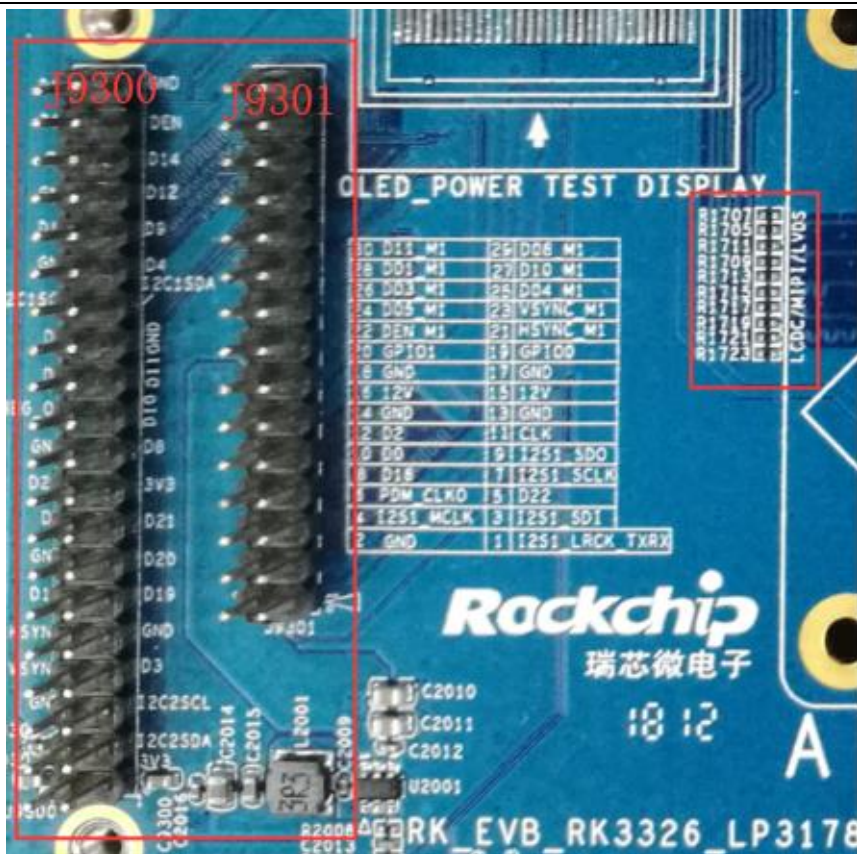


图 3-18 EVB RGB扩展座

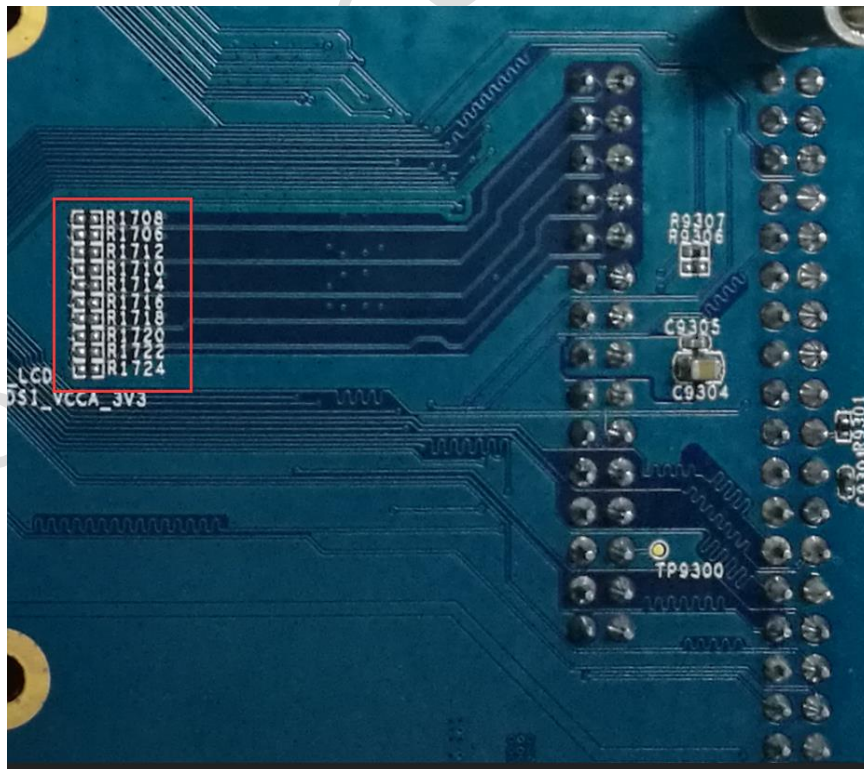


图 3-19 RGB扩展座信号选择

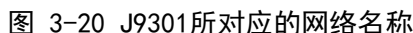


表 3-5 J9301接口所对应的网络名称及主控引脚名称

J9301接口引脚号	J9301接口引脚网络名称	J9301接口对应主控引脚名称
1	I2S1_LRCK_TXRX	I2S1_LRCK_TXRX/GPI02_C1_d
2	GND	GND
3	I2S1_SDI	PDM_SDI0_M1/I2S1_SDI/GPI02_C5_d
4	I2S1_MCLK	I2S1_MCLK/GPI02_C3_d
5	LCDC_D22	ISP_FLASH_TRIGOUT/PDM_SDI3/CIF_HREF_M1/ LCDC_D22/GPI03_D2_d
6	PDM_CLK0	N/A
7	I2S1_SCLK	I2S1_SCLK/GPI02_C2_d
8	LCDC_D18	PDM_CLK0_M0/LCDC_D18/GPI03_C6_d
9	I2S1_SDO	I2S1_SDO/GPI02_C4_d
10	LCDC_D0	LCDC_D0/GPI03_A4_d
11	LCDC_CLK	LCDC_CLK/GPI03_A0_d
12	LCDC_D2	LCDC_D2/GPI03_A6_d
13	GND	GND
14	GND	GND
15	VCC12V_DCIN	N/A
16	VCC12V_DCIN	N/A
17	GND	GND
18	GND	GND
19	SDMMC0_DET	SDMMC0_DET/GPI00_A3_u
20	SENSOR_INT	OTG_DRV/PWM0/GPI00_B7_d
21	C_LVDS/MIPI_TX_D3N	LVDS/MIPI_TX_D3N/LCDC_HSYNC_M1
22	C_LVDS/MIPI_TX_D3P	LVDS/MIPI_TX_D3P/LCDC_DEN_M1
23	C_LVDS/MIPI_TX_D2N	LVDS/MIPI_TX_D2N/LCDC_VSYNC_M1
24	C_LVDS/MIPI_TX_D2P	LVDS/MIPI_TX_D2P/LCDC_D5_M1
25	C_LVDS/MIPI_TX_CLKN	LVDS/MIPI_TX_CLKN/LCDC_D4_M1
26	C_LVDS/MIPI_TX_CLKP	LVDS/MIPI_TX_CLKP/LCDC_D3_M1
27	C_LVDS/MIPI_TX_D1P	LVDS/MIPI_TX_D1P/LCDC_D10_M1
28	C_LVDS/MIPI_TX_D1N	LVDS/MIPI_TX_D1N/LCDC_D1_M1
29	C_LVDS/MIPI_TX_D0P	LVDS/MIPI_TX_D0P/LCDC_D8_M1
30	C_LVDS/MIPI_TX_D0N	LVDS/MIPI_TX_D0N/LCDC_D11_M1

3.13 Raspberry Pi 接口

开发板上预留树莓派2代B版本接口插座，如下图所示。



图 3-21 EVB Raspberry Pi接口

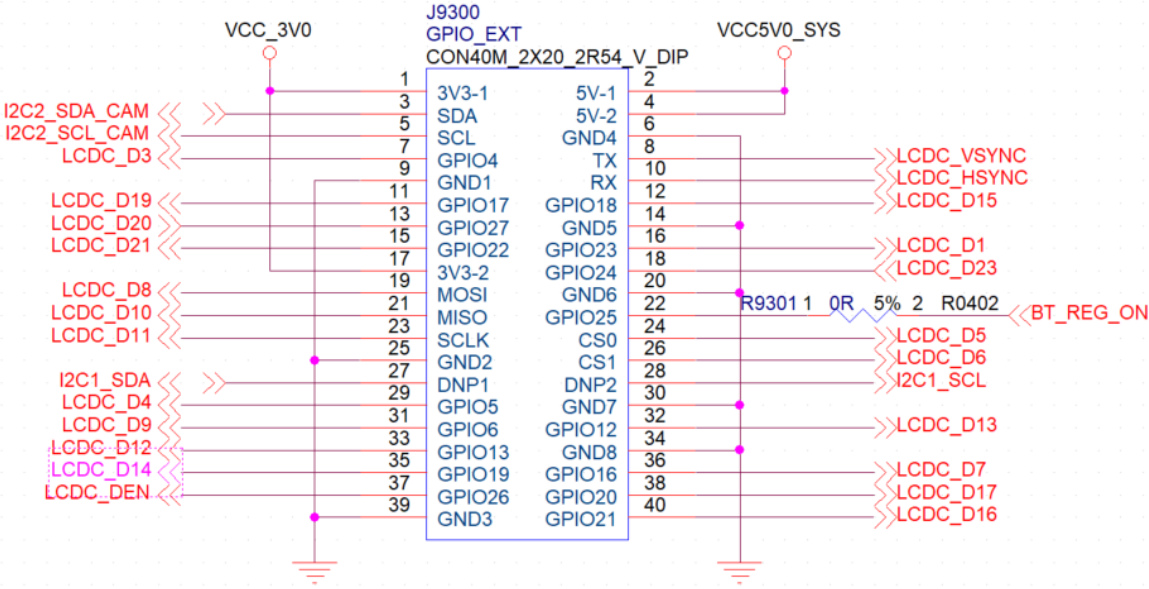


图 3-22 树莓派接口 (J9300) 引脚网络名称

表 3-6 树莓派接口 (J9300) 引脚网络名称及对应主控引脚名称

树莓派接口引脚号	树莓派接口引脚网络名称	树莓派接口对应主控引脚名称
1	VCC_3V0	VCC104
2	VCC5V0_SYS	N/A
3	I2C2_SDA_CAM	I2C2_SDA/GPIO2_CO_u

4	VCC5V0_SYS	N/A
5	I2C2_SCL_CAM	I2C2_SCL/GPI02_B7_u
6	GND	GND
7	LCDC_D3	I2S2_2CH_SD0/CIF_D4_M1/LCDC_D3_M0/GPI03_A7_d
8	LCDC_VSYNC	I2S2_2CH_SCLK/LCDC_VSYNC_M0/GPI03_A2_d
9	GND	GND
10	LCDC_HSYNC	I2S2_2CH_MCLK/LCDC_HSYNC_M0/GPI03_A1_d
11	LCDC_D19	PDM_CLK1/LCDC_D19/GPI03_C7_d
12	LCDC_D15	TDM_SCLK/I2S0_8CH_SCLKTX/LCDC_D15/GPI03_C3_d
13	LCDC_D20	PDM_SD11/CIF_CLKOUT_M1/LCDC_D20/GPI03_D0_d
14	GND	GND
15	LCDC_D21	ISP_PRELIGHT_TRIG/PDM_SD12/CIF_VSYNC_M1/LCDC_D21/GPI03_D1_d
16	LCDC_D1	I2S2_2CH_SDI/CIF_D3_M1/LCDC_D1_M0/GPI03_A5_d
17	VCC_3V0	VCC104
18	LCDC_D23	ISP_FLASH_TRIGIN/PDM_SD10_M0/CIF_CLKIN_M1/LCDC_D23/GPI03_D3_d
19	LCDC_D8	SPI1_MOSI/I2S0_8CH_SCLKRX/CIF_D7_M1/LCDC_D8_M0/GPI03_B4_d
20	GND	GND
21	LCDC_D10	SPI1_MISO/I2S0_8CH_SD03/CIF_D8_M1/LCDC_D10_M0/GPI03_B6_d
22	BT_REG_ON	GPI00_C1_d
23	LCDC_D11	SPI1_CLK/I2S0_8CH_SD02/CIF_D9_M1/LCDC_D11_M0/GPI03_B7_d
24	LCDC_D5	SPI1_CSNO/I2S0_8CH_SD12/CIF_D6_M1/LCDC_D5_M0/GPI03_B1_d
25	GND	GND
26	LCDC_D6	SPI1_CSN1/LCDC_D6/GPI03_B2_d
27	I2C1_SDA	I2C1_SDA/GPI00_C3_d
28	I2C1_SCL	I2C1_SCL/GPI00_C2_d
29	LCDC_D4	I2S0_8CH_SD13/CIF_D5_M1/LCDC_D4_M0/GPI03_B0_d
30	GND	GND
31	LCDC_D9	I2S0_8CH_LRCKRX/LCDC_D9/GPI03_B5_d
32	LCDC_D13	I2S0_8CH_MCLK/LCDC_D13/GPI03_C1_d
33	LCDC_D12	I2S0_8CH_SD01/LCDC_D12/GPI03_C0_d
34	GND	GND
35	LCDC_D14	TDM_FSYNC/LCDC_D14/I2S0_8CH_LRCKTX/GPI03_C2_d
36	LCDC_D7	I2S0_8CH_SD11/LCDC_D7/GPI03_B3_d
37	LCDC_DEN	I2S2_2CH_LRCK/CIF_D2_M1/LCDC_DEN_M0/GPI03_A3_d
38	LCDC_D17	TDM_SDI/I2S0_8CH_SD10/LCDC_D17/GPI03_C5_d
39	GND	GND
40	LCDC_D16	TDM_SD0/I2S0_8CH_SD00/LCDC_D16/GPI03_C4_d

3.14 UART Debug调试座

开发板提供串口供开发调试使用，如下图所示。板上选用PL-2303HX高度集成的FT232-USB接口转换芯片。

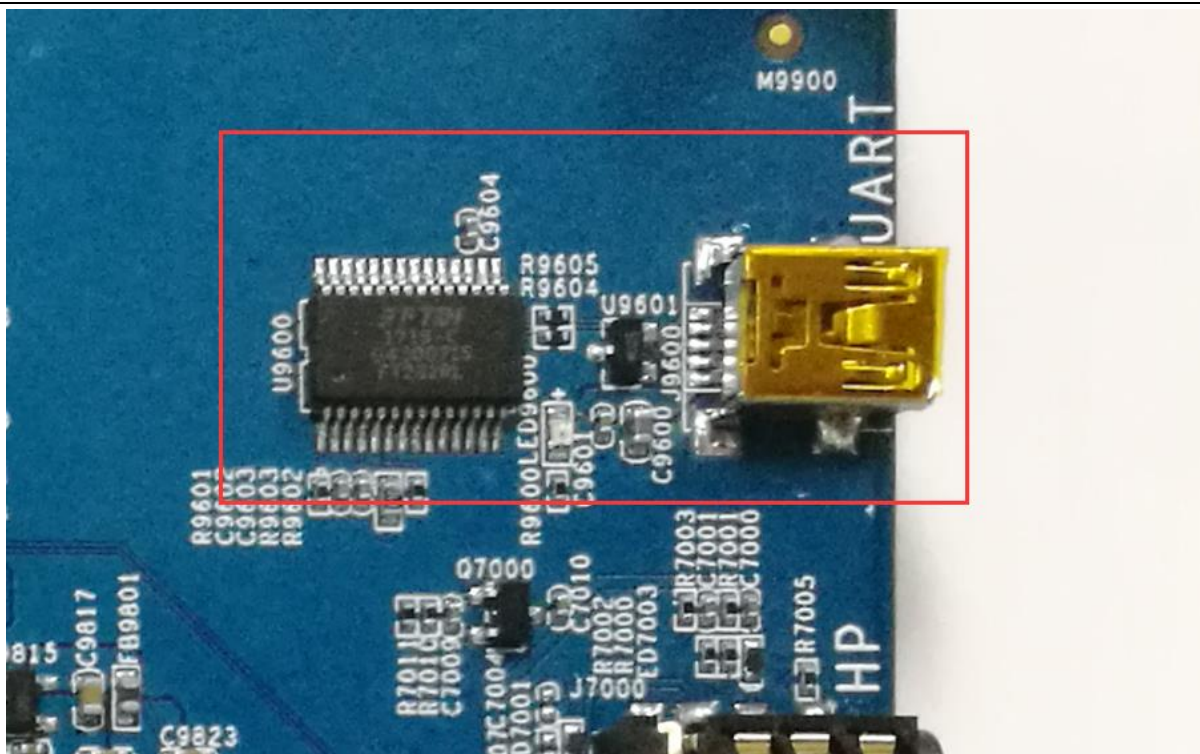


图 3-23 EVB UART Debug调试座 (Mini USB)

3.15 JTAG Debug调试座

开发板采用标准的20pin JTAG调试接口，方便客户通过JTAG进行调试开发，如下图所示。

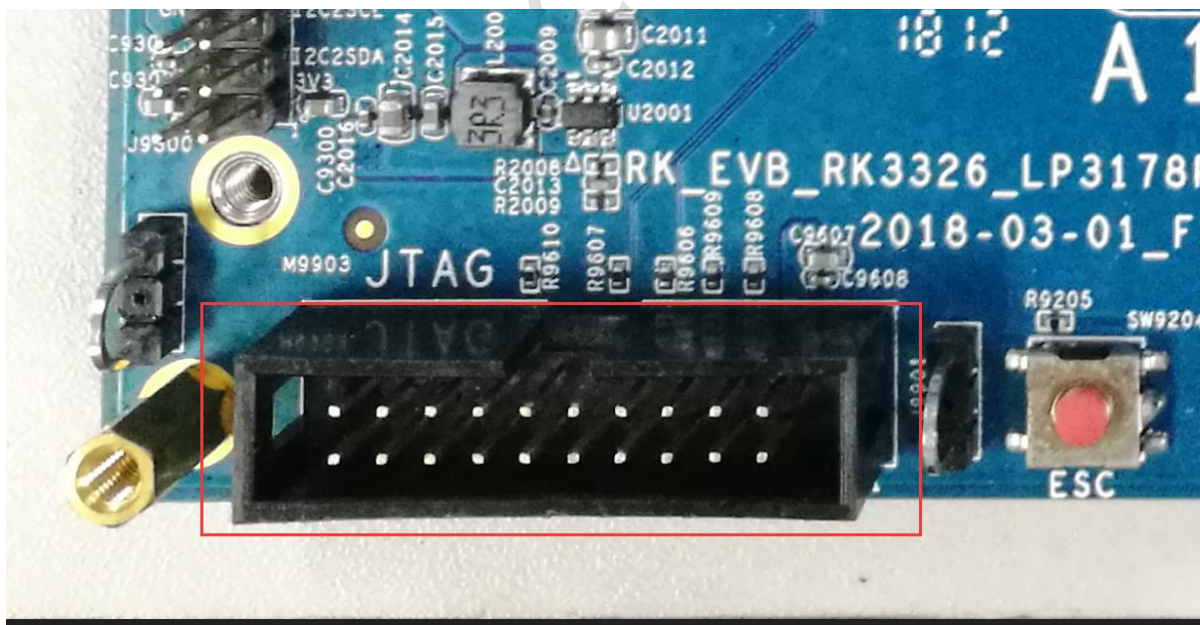


图 3-24 EVB JTAG Debug调试座

4. 开发板使用

4.1 EVB开关机和待机

EVB开机和关机方法介绍如下：

1、开机方法：

（1）使用DC 12V供电，打开电源总开关，短按Power键0.5s以上，即可开机。

（2）使用单节电池供电，短按Power键0.5s以上，即可开机。

2、关机方法：

长按Power键2s，在显示屏窗口界面点击关机。

3、异常关机方法：

（1）使用单电池供电，异常情况下，可以长按Power键8s进入强制关机；或者点击Reset按钮重新复位；

（2）使用DC 12V供电，异常情况下，除以上方式，还可以通过关闭船型开关电源来关闭开发板电源。

4、待机的方法：

在桌面或者应用场景下，按下Power键，系统会进入一级待机状态。在没有连接USB的情况下，不做任何操作，系统会在一段时间后，由一级待机转入二级待机状态

4.2 USB驱动安装

EVB在固件烧写、驱动升级以及ADB连接前需要先安装USB驱动程序，驱动工具路径：

SDK\RKTools\windows\Release_DriverAssitant目录下，打开“DriverInstall.exe”，点击“驱动安装”，提示“安装驱动成功”即可。如果已安装旧驱动，请点击“驱动卸载”，并重新安装驱动。

驱动文件目前仅支持Windows。

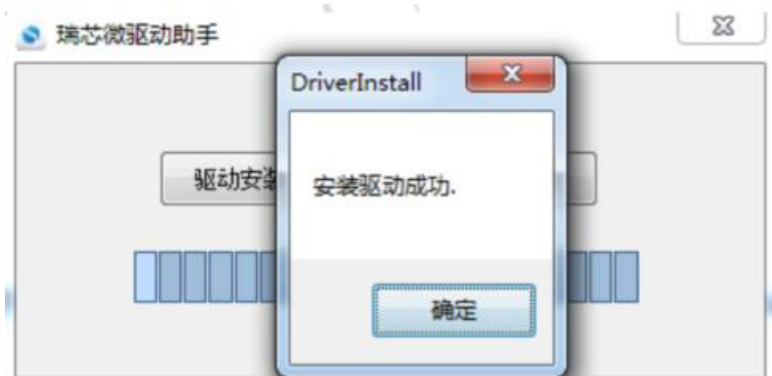


图 4-1 驱动安装成功示意图

4.3 EVB固件烧写

RK3326 EVB有两种固件烧写方式：

4.3.1 Maskrom烧写模式

基本原理是在系统上电前将FLASH_D0对地短路，使Flash引导失败，从而进入Maskrom状态。适用于烧写了错误的bootloader文件，无法正常引导系统开机的情况下。

具体步骤如下：

- 1、连接USB到电脑PC端，并按住开发板的Maskrom按键不放；
- 2、给EVB供电12V，并打开船型开关；要是已经处于上电情况下，请按下复位按键。
- 3、等待会儿开发工具将显示“发现一个Maskrom设备”，需要注意的是在Maskrom状态下需要同时选择对应的Loader才能升级。
- 4、开发工具选择对应的image文件。
- 5、点击执行，即进入升级状态，在工具的右侧有进度显示栏，显示下载与校验情况。

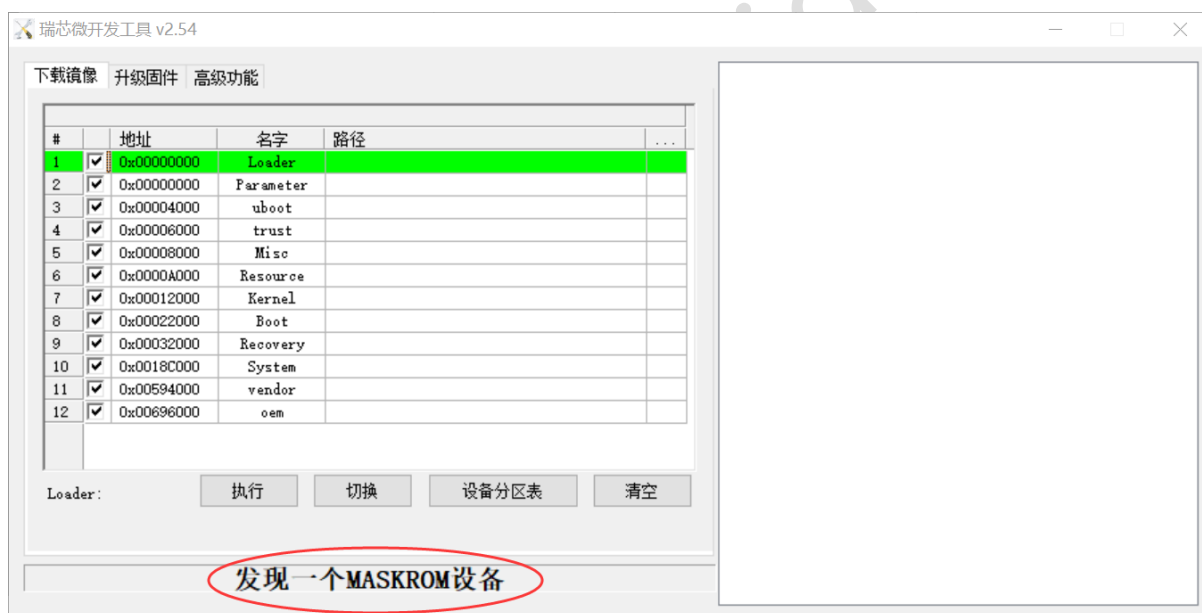


图 4-2 进入Maskrom烧写模式工具上示意图

4.3.2 Loader烧写模式

基本原理在系统上电或重启前保证ADC2_KEY_IN是低电平，上电或重启后系统将进入Loader状态。适用于正常情况下，更换固件中的一小部分或者全部。

具体步骤如下：

- 1、并按住开发板的Vo1+/RECOVER按键不放，连接USB到电脑PC端。
- 2、给EVB供电12v，并打开船型开关；要是已经处于上电情况下，请按下复位按键。
- 3、等待会儿开发工具将显示“发现一个Loader设备”，需要注意的是在Loader模式下不需要烧写完整的固件，可以只选择需要更新的image文件。

4、开发工具选择对应的image文件。

5、点击执行，即进入升级状态，在工具的右侧有进度显示栏，显示下载与校验情况。

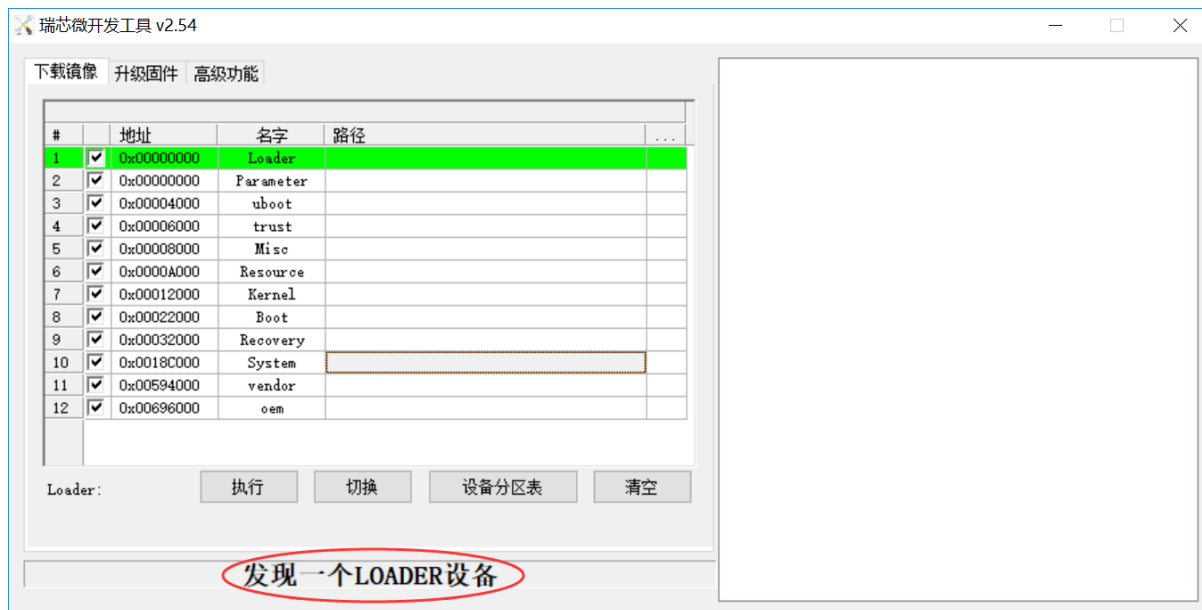


图 4-3 进入Loader烧写模式工具上示意图

4.4 串口调试

4.4.1 连接串口

连接EVB板的USB Debug到电脑PC端，在PC端设备管理器中得到当前端口的COM号。

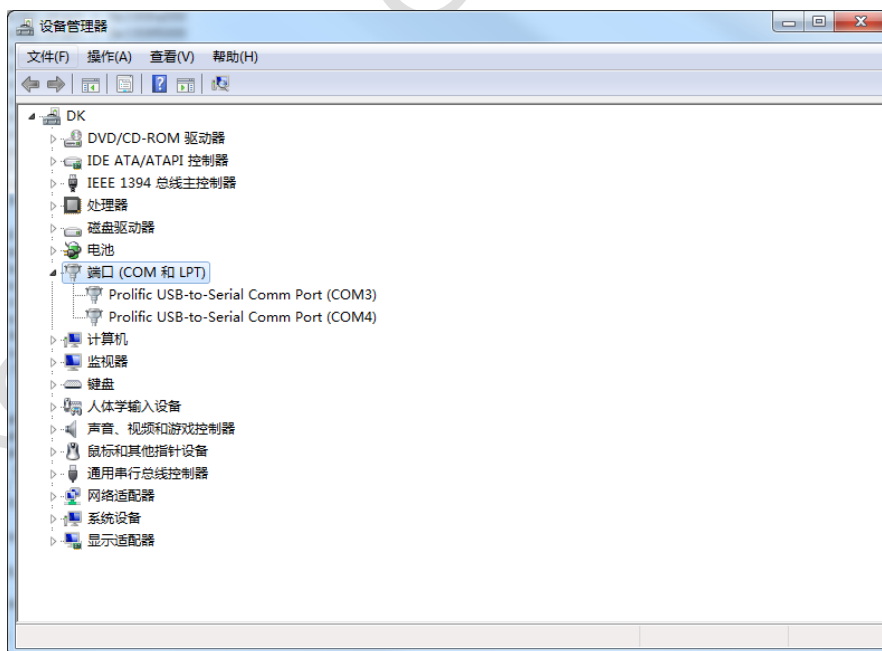


图 4-4 获取当前端口COM号

打开串口工具“SecureCRT”，点击“快速连接”按钮。

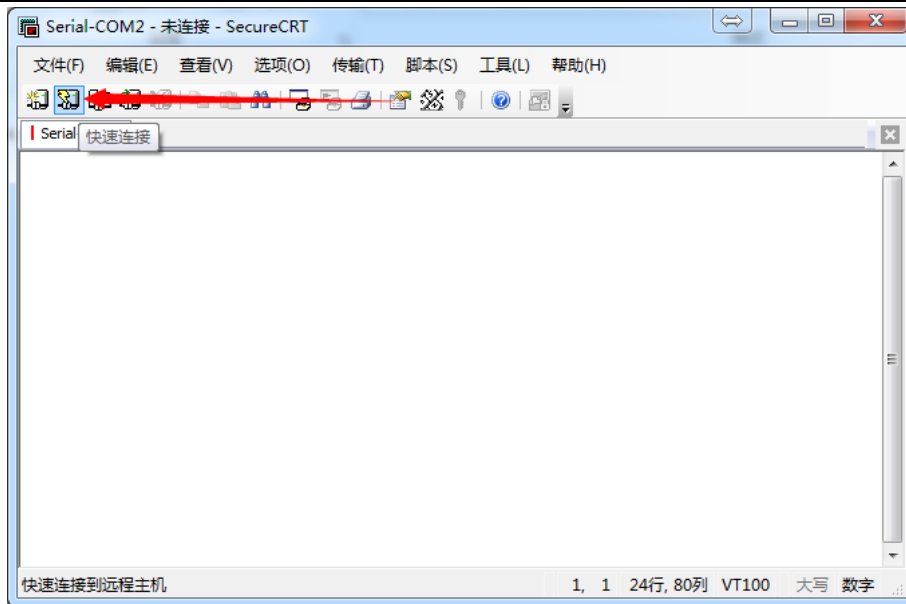


图 4-5 串口工具SecureCRT界面

配置串口，如下图所示，端口选择连接开发板的端口号，波特率选择1.5M，流控RTS/CTS不需勾选。

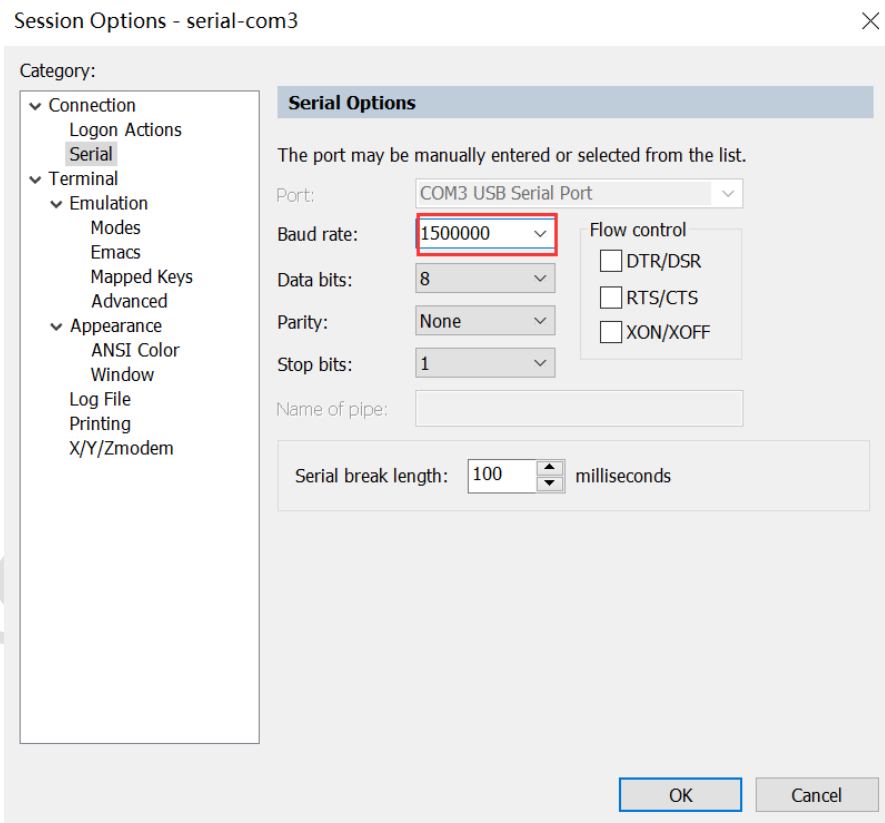


图 4-6 配置串口信息

点击连接，就能正常连接设备了。为方便调试，配置会话选项，点击工具栏“会话选项”，回滚缓冲区设置较大数，可以保存更多的log信息。

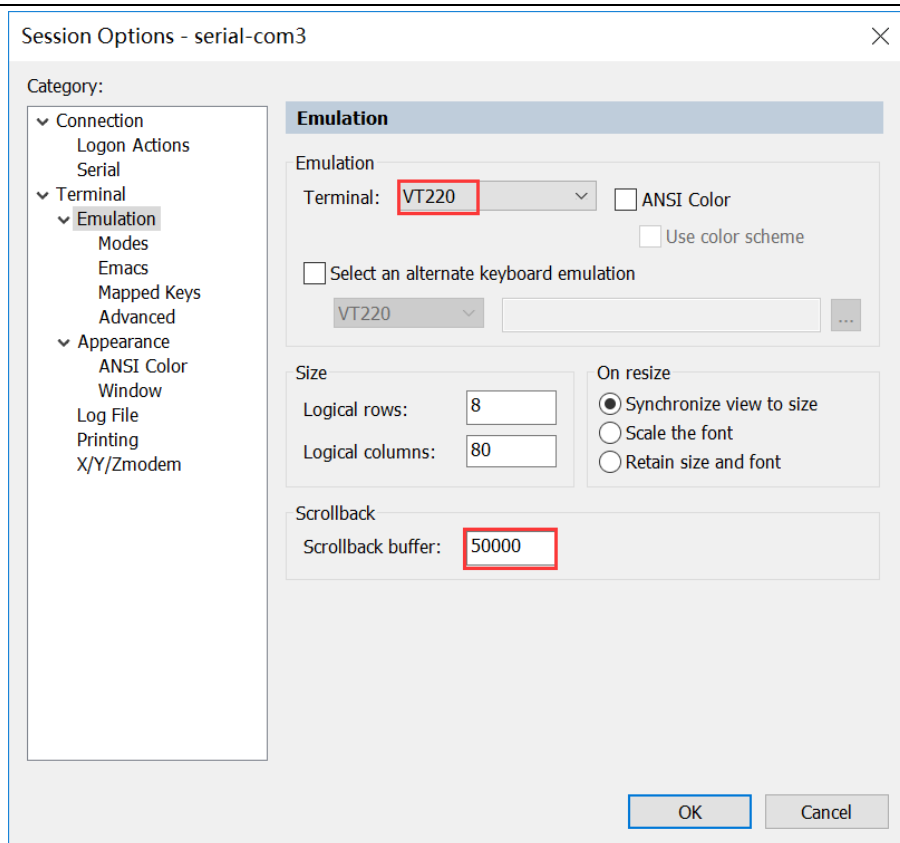


图 4-7 配置串口工具选项

4.4.2 ADB调试

1. 确保驱动安装成功，PC连接开发板的USB OTG口；
2. 开发板上电，开机进入系统，再进入setting项，选择“developer options”，勾选“USB debugging”；
3. 电脑PC端，点击“开始——运行”，输入cmd，进入adb.exe工具所在的目录，输入“adb devices”，可以查询到连接的设备，表示连接正常；
4. 输入“adb shell”，进入ADB调试。

```
Ctrl+Run - adb shell
```

```
F:\RK\Driver\adb tools>adb shell
rk3326:/ $
rk3326:/ $ su
su
rk3326:/ #
rk3326:/ #
rk3326:/ #
```

图 4-8 ADB连接正常

5. 注意事项

5.1 注意事项

RK3326 EVB适用于实验室或者工程开发环境，在开始操作之前，请先阅读以下注意事项：

- 任何情况下都不可以对开发板的屏幕接口及扩展板进行热插拔操作。
- 在拆封开发板包装和安装之前，为避免静电释放（ESD）对开发板硬件造成损伤，请采取必要的防静电措施。
- 手持开发板时请拿开发板的边沿，不要触碰到开发板上的外露金属部分，以免静电对开发板元器件造成损坏。
- 请将RK3326开发板放置于干燥的平面上，以保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。